

IC载板BT板料HL832NXA基板多层超薄PCB电路板MBBGA封装基板

产品名称	IC载板BT板料HL832NXA基板多层超薄PCB电路板MBBGA封装基板
公司名称	深圳嘉圳电子科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	嘉圳:IC载板 BGA:MBBGA 深圳:宝安
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路星际大厦3A09
联系电话	18680337466 18680337466

产品详情

封装基板用于承载芯片，连接芯片与 PCB 母板。封装基板是一类用于承载芯片的线路板，属于 PCB 的一个技术分支，也是核心的半导体封装材料，具有高密度、高精度、高性能、小型化及轻薄化的特点，可为芯片提供支撑、散热和保护的作用，同时也可为芯片与 PCB 母板之间提供电气连接及物理支撑。

封装基板的产品工艺不断地随着封装形式演进，层数不断增加，特别是在以CPU/GPU等为代表的逻辑计算芯片的主流封装都采用封装基板（Substrate），在未来相当长的时间内封装基板（Substrate）不仅不会退出，反而因为芯片功能的复杂性增加，封装基板将会在越来越多的领域替代传统的引线框架封装形式。对于封装基板生产厂家而言，随着工艺的复杂性及技术含量的增加，基板的价格及利润率都会随之而增加。

根据咨询机构 Prismark 测算，2021-2026年封装基板行业有望从 2021 年的 142 亿美元增长至 2026 年的 214 亿美元，复合增长率达到 8.6%，其中FC-BGA 年复合增速 10%，超越FC-CSP 年复合增速5%。高加工难度与高投资门槛铸就封装基板核心壁垒，相关厂商具备先发优势形成相对稳定的竞争格局，2020 年qianshi大封装基板厂商集中度高达 83%。

图 不同类型的封装基板针对不同的下游应用

封装基板细分工艺对应不同的产品，主要可分为三个等级。参照《印制电路信息》入门级产品包括 CSP、PBGA，用于芯片组、DRAM、Flash 产品;一般类包括一般FCCSP 和FCBGA (非CPU 类)，可用于通信芯片组、SiP 装模组;高端类包括复杂FCBGA (CPU 类) 产品，可用于 CPU、GPU 等产品。全球范围内，中国台湾的欣兴、景硕、南亚，日本揖斐电、奥地利 AT&S 均有涉及高端类产品。